

2023年3月期

第3四半期決算説明

2023年2月8日

芝浦メカトロニクス株式会社

3Q累計業績サマリー

* 3Q累計：4月～12月

■ 売上高・利益

- 対前年 増収増益
- 売上高は、売上の前倒しなどから増加し 455億円
- 営業利益は、前年比2.8倍の 83.2億円 (ROS 18.3%)
- 当期純利益は、前年比4.0倍の 61.4億円

■ 受注高

- 半導体前工程が堅調で、前年比1.1倍の 589億円
3Qは設備投資計画の見直しや時期ずれ等があり減少、
4Qでは増加の見込み。

3Q累計業績結果 (対前年)

【連結】

単位：億円

	2021						2022			3Q 累計	対前年 増減率
	1Q	2Q	3Q	3Q 累計	4Q	年度	1Q	2Q	3Q		
売上高	101	118	118	337	156	493	138	154	162	455	+35%
営業利益	6.6	11.9	11.3	29.7	20.8	50.5	21.2	24.8	37.2	83.2	+180%
R O S	6.5%	10.1%	9.6%	8.8%	13.3%	10.3%	15.3%	16.1%	23.0%	18.3%	+9.5pt
経常利益	6.1	11.4	10.8	28.3	20.5	48.8	19.1	23.5	35.2	77.8	+175%
特別損失	6.1	-	-	6.1	-	6.1	-	-	-	-	-
当期純利益	▲1.9	9.4	7.7	15.2	14.6	29.8	16.8	17.4	27.2	61.4	+303%
受注高	149	145	242	536	173	709	289	185	114	589	+10%

3Q累計業績結果まとめ (対前年) ①

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比35%増収 (337億円 ⇒ 455億円)
 - SPE分野が増加し、FPD分野は前年同等だが、全体として増収
- 営業利益 前年比180%増益 (29.7億円 ⇒ 83.2億円)
 - SPE前工程分野の売上増加と利益率の改善により、営業利益は増益
- 当期純利益 前年比303%増益 (15.2億円 ⇒ 61.4億円)
 - 営業利益の改善が寄与し当期純利益は増益
- 受注高 前年比10%増加 (536億円 ⇒ 589億円)
 - SPE前工程分野が堅調、FPD分野は顧客の設備投資計画の見直しがあり低調だが、全体として増加

3Q累計業績結果まとめ（対前年）②

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

- **売上高** 前年比47%増 (212億円 ⇒ 312億円)
半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやパワーデバイス向け、ウェーハ向けがいずれも順調で増加。
FPD前工程では、前年度受注低調の影響などで減少。
- **セグメント利益** 前年比335%増 (15.9億円 ⇒ 69.2億円)
半導体前工程の売上増加などにより大幅増益。
- **受注高** 前年比29%増 (347億円 ⇒ 448億円)
半導体前工程では、全体として堅調に推移。
FPD前工程では、大型・中小型パネル向けとも低調に推移。

3Q累計業績結果まとめ（対前年）③

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

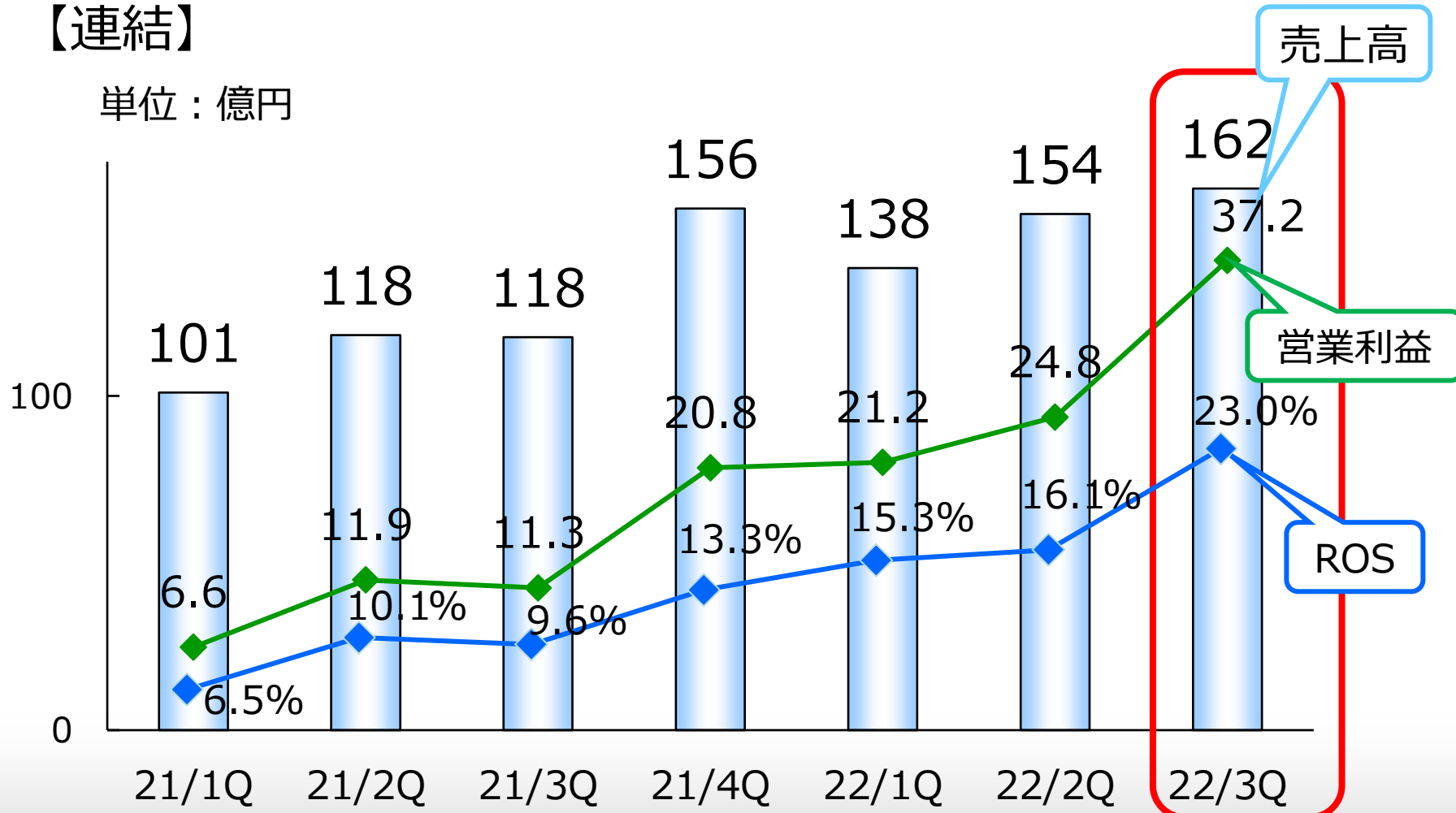
- **売上高** 前年比17%増（96億円 ⇒ 112億円）
半導体後工程では、先端パッケージ向けを中心に堅調に推移。
FPD後工程では、TV・モニタ用途の大型パネル向けが堅調で増加。
真空部門では、電子部品向けや半導体向けが堅調で増加。
- **セグメント利益** 前年比17%増（13.6億円 ⇒ 15.9億円）
売上増加などにより増益。
- **受注高** 前年比29%減（155億円 ⇒ 110億円）
半導体後工程では、一部顧客の投資計画見直しがあり低調に推移。
FPD後工程では、モニタ用パネル向け・車載用パネル向けで受注があったが低調に推移。
真空部門では、電子部品向けや半導体向けが順調に推移。

売上高・利益・ROS

SPE分野が増加し ROS23.0%

【連結】

単位：億円



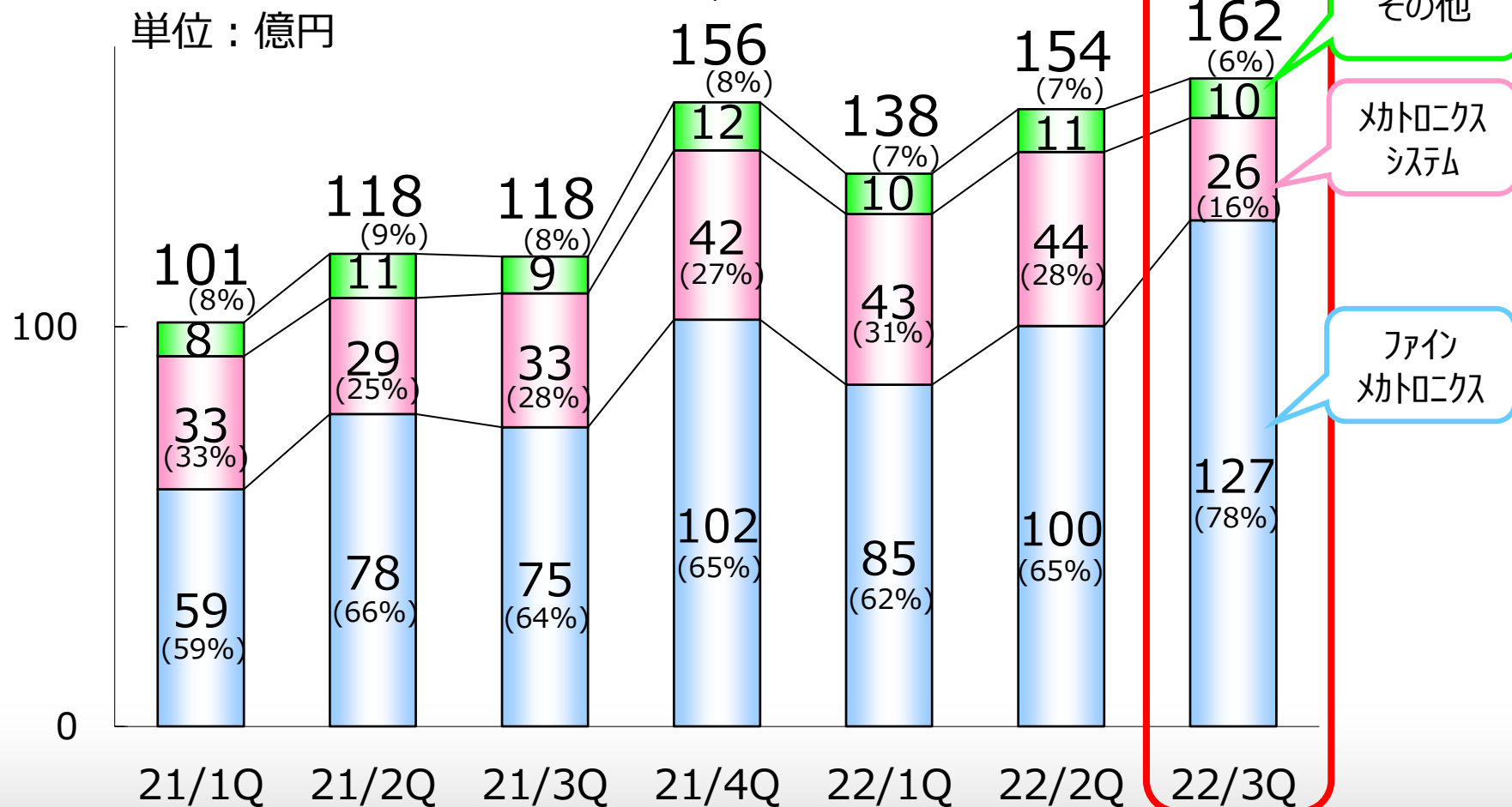
セグメント別売上高

ファインメカトロニクスが78%

【連結】

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



分野別売上高

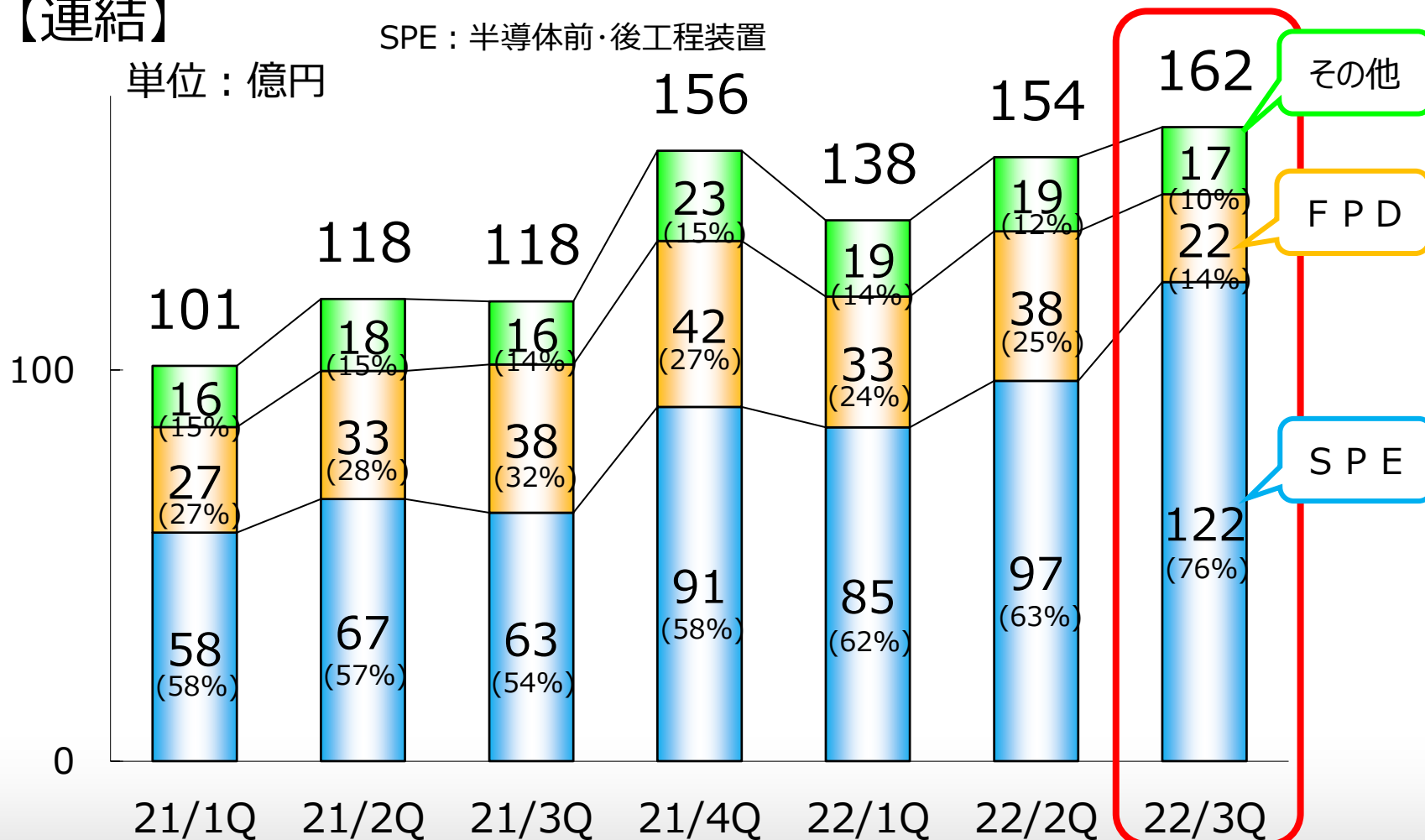
SPE分野が増加し76%

【連結】

* FPD : FPD前・後工程装置

SPE : 半導体前・後工程装置

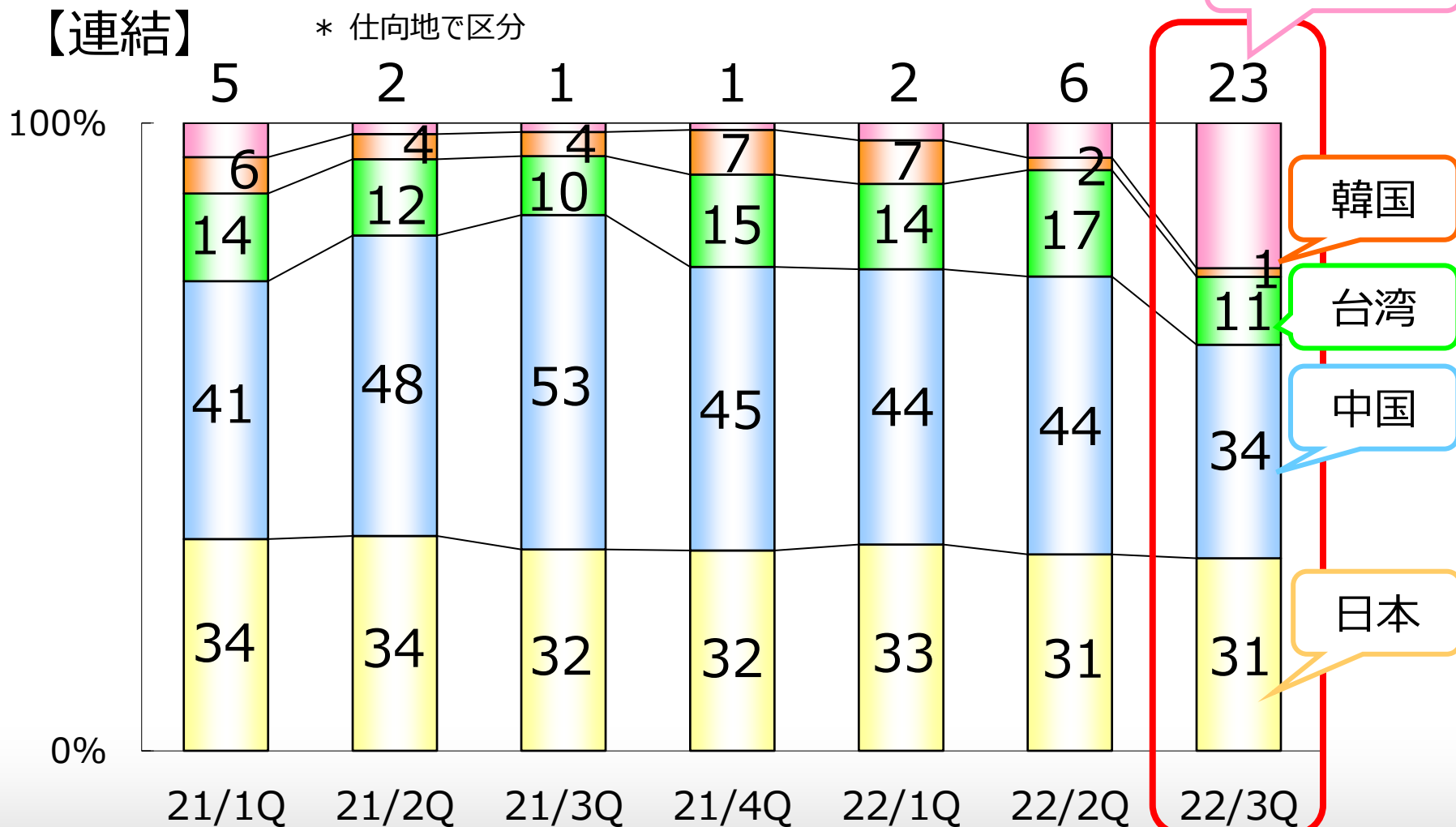
単位：億円



地域別売上高比率

海外向け69% (中国34%)

欧米・東南アジア
・他

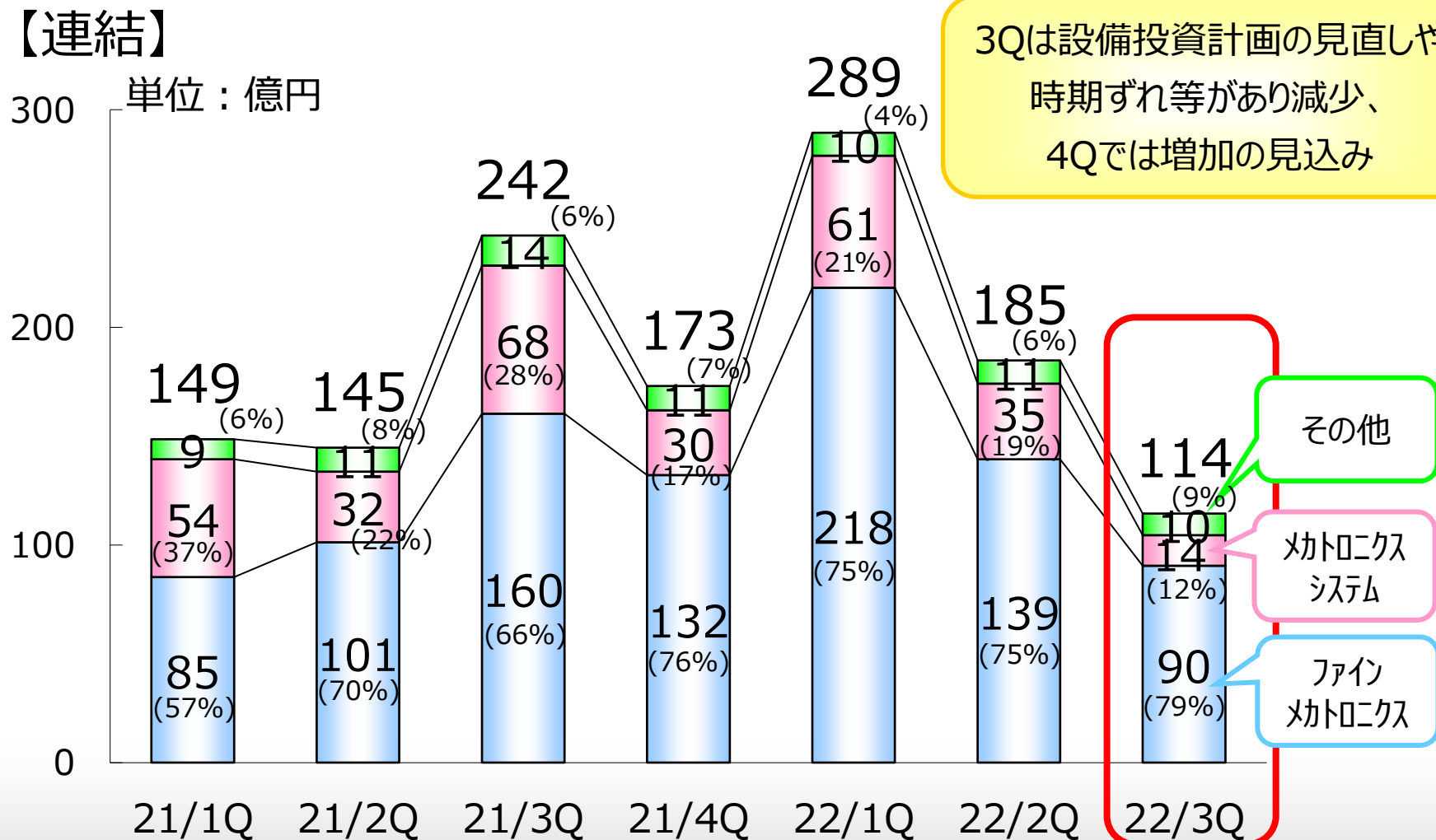


セグメント別受注高

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置

メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

3Qは設備投資計画の見直しや
時期ずれ等があり減少、
4Qでは増加の見込み



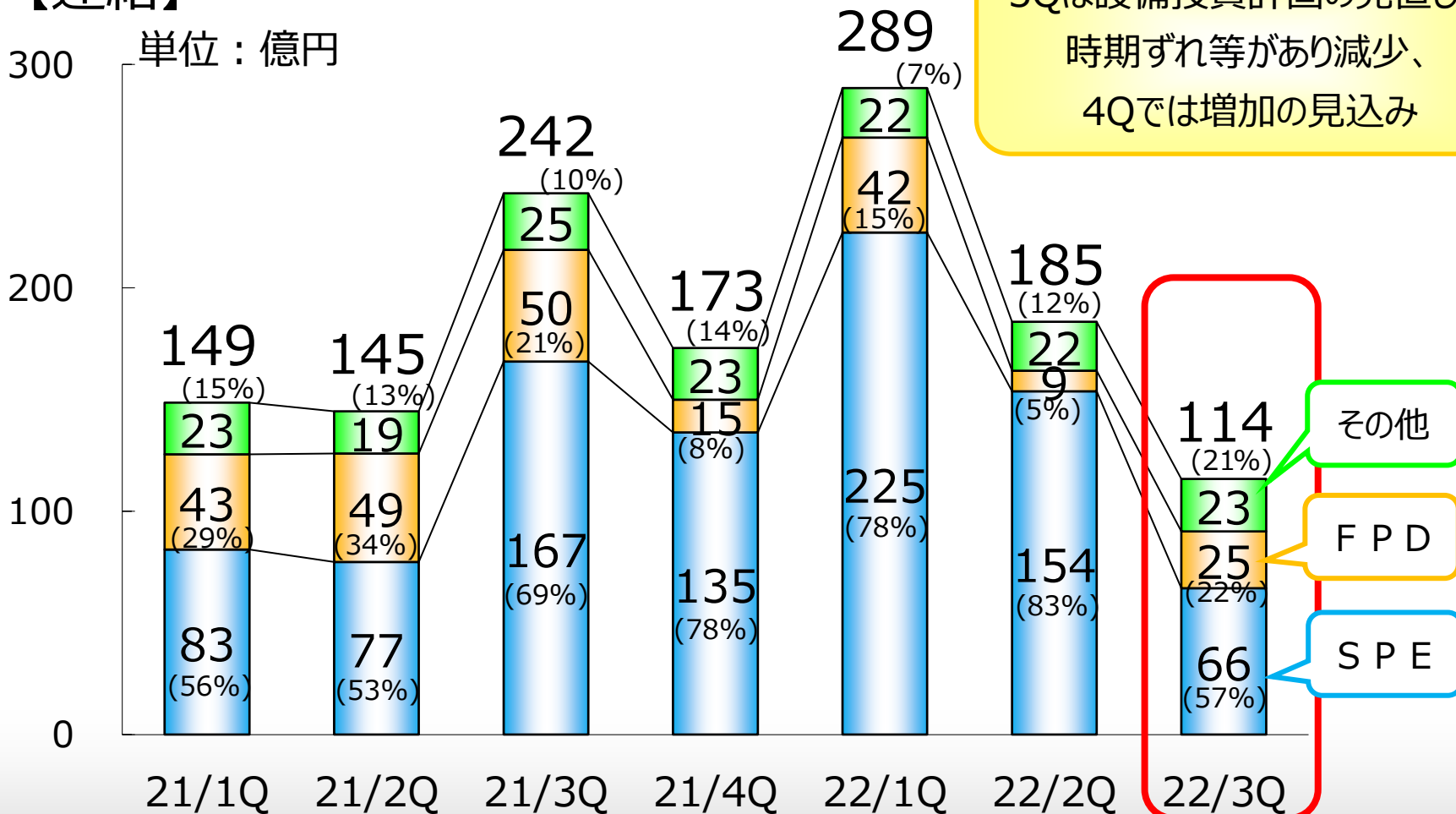
分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

【連結】

単位：億円



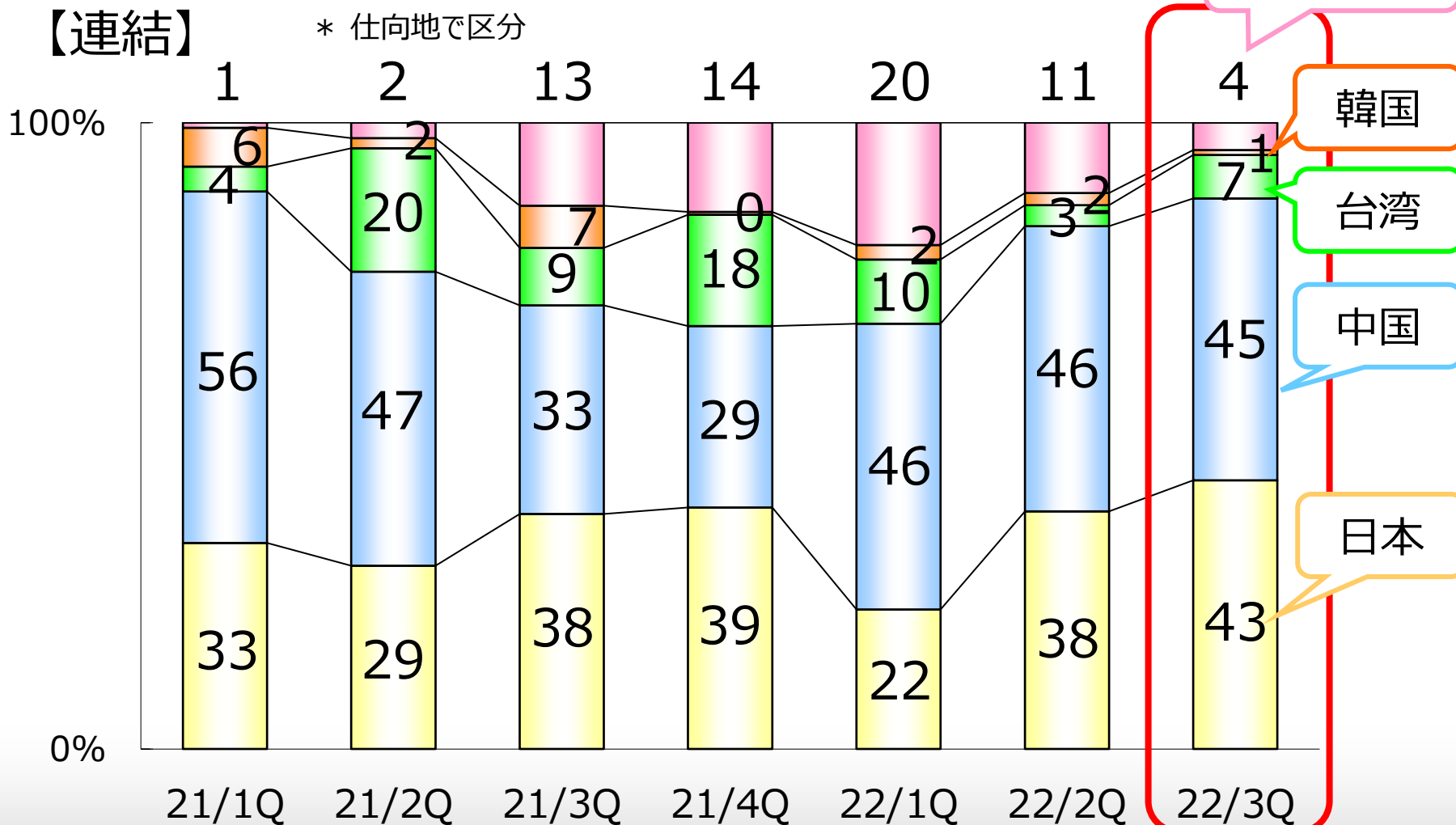
3Qは設備投資計画の見直しや時期ずれ等があり減少、4Qでは増加の見込み

Legend for 2022/3Q data:

- Other (その他) - Green box
- FPD - Orange box
- SPE - Blue box

地域別受注高比率

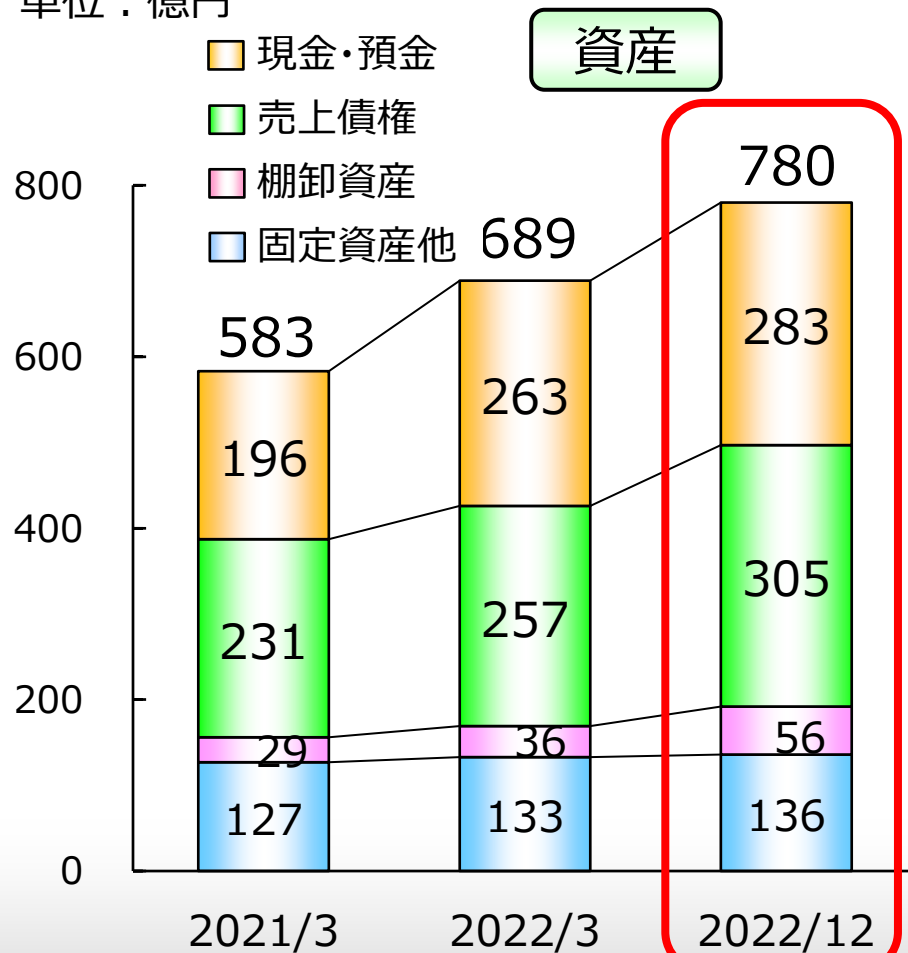
海外向け57% (中国45%)



貸借対照表

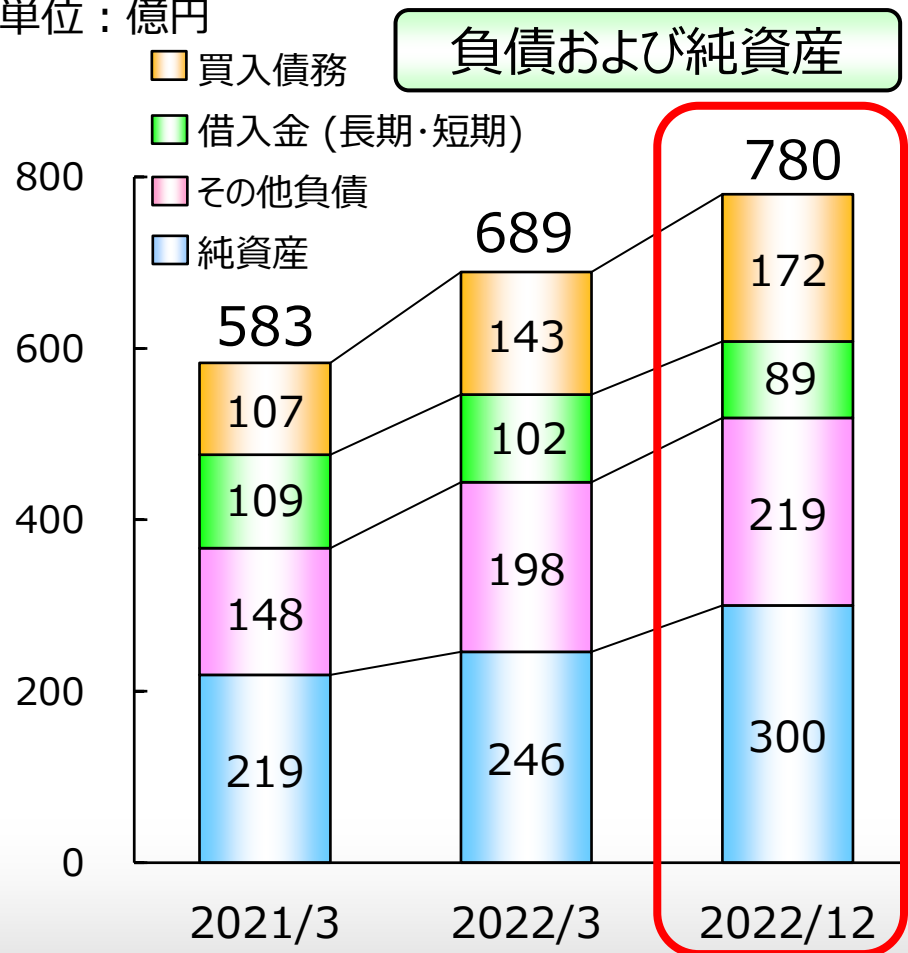
【連結】

単位：億円



自己資本比率 36% ('22/3) → 38% ('22/12)
D/Eレシオ 41% ('22/3) → 30% ('22/12)

単位：億円



業績予想

【連結】

前回予想から売上高、利益とも
上回る見込み

*1: 2022年5月公表

*2: 2022年11月公表

単位：億円

	2021年度			2022年度		2022年度 予想
	21/3Q 累計	21/4Q	2021 年度	22/3Q 累計実績	22/4Q 予想	
売上高	337	156	493	455	135	590
営業利益	29.7	20.8	50.5	83.2	16.8	100.0
R O S	8.8%	13.3%	10.3%	18.3%	12.4%	16.9%
経常利益	28.3	20.5	48.8	77.8	18.2	96.0
特別損失	6.1	-	6.1	-	-	-
当期純利益	15.2	14.6	29.8	61.4	13.6	75.0
R O E	-	-	12.8%	-	-	26.8%
配当	-	-	230円	-	-	510円

前回予想 *2 2022 年度	期初予想 *1 2022 年度
560	560
76.0	67.0
13.6%	12.0%
72.0	65.0
-	-
58.0	51.0
21.4%	19.1%
390円	350円

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。
2022年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は、
前回予想から120円増配の510円を予定しています。
(前年から280円増配)

	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想 (2023年3月期)	0円	510円	510円
前回予想 (2023年3月期)	0円	390円	390円
前年 (2022年3月期)	0円	230円	230円

SPE

- グローバルニッチトップ対象製品群の売上堅調
SPE売上高122億円の内、GNT85億円（70%）で推移
- 枚葉式Siウェーハ洗浄装置が引き続き堅調
- 後工程のフリップチップボンダでは、一部顧客の設備投資計画見直し

* GNT : 現中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群

FPD

- 前工程では、設備投資が低水準。利益率は改善。
- 後工程では、車載用に注力継続

生産面

- 部品納期の長期化傾向は継続するも、サプライチェーンとのさらなる連携強化で対応

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

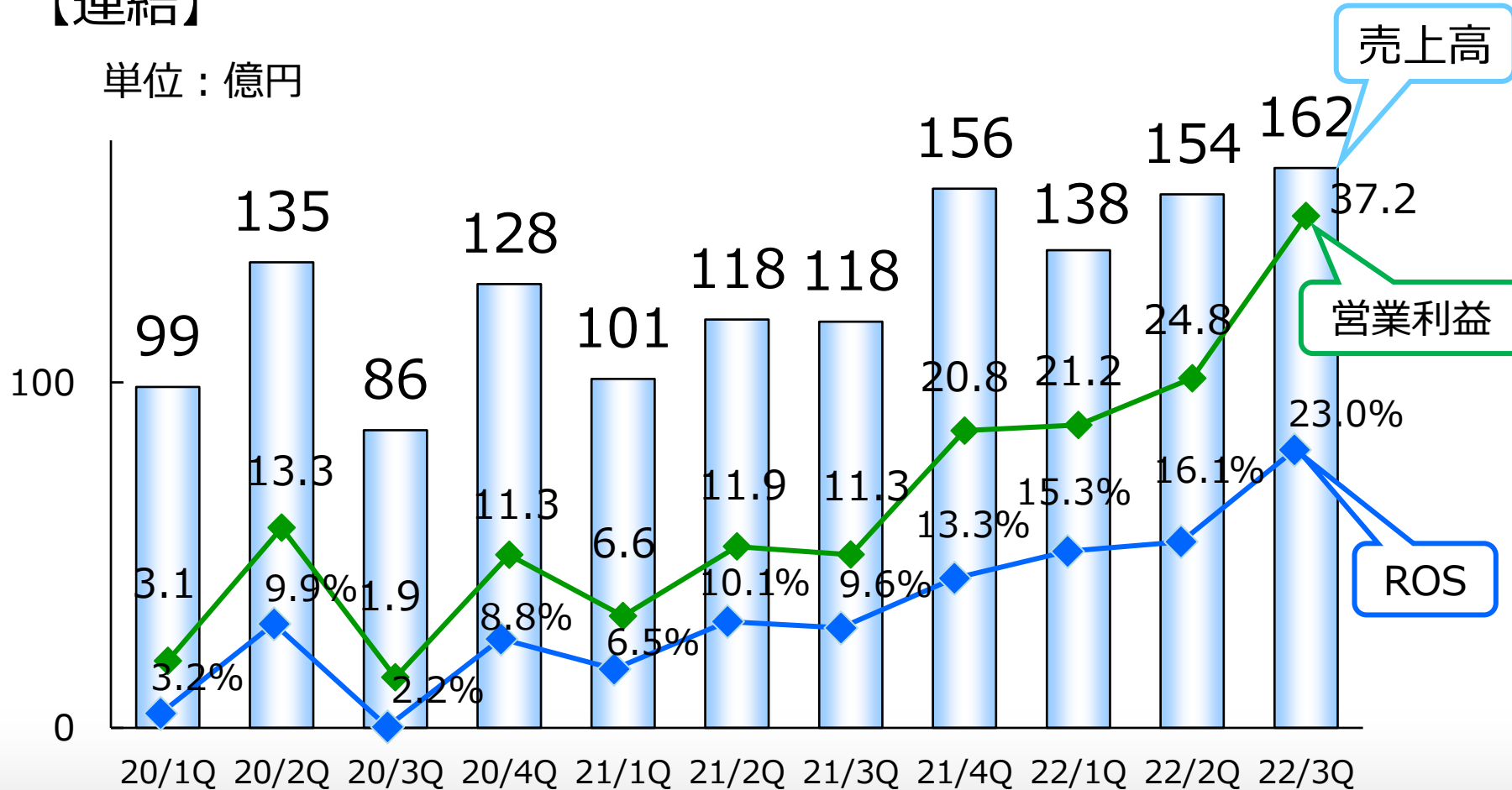
END

Appendix

売上高・利益・ROS

【連結】

単位：億円



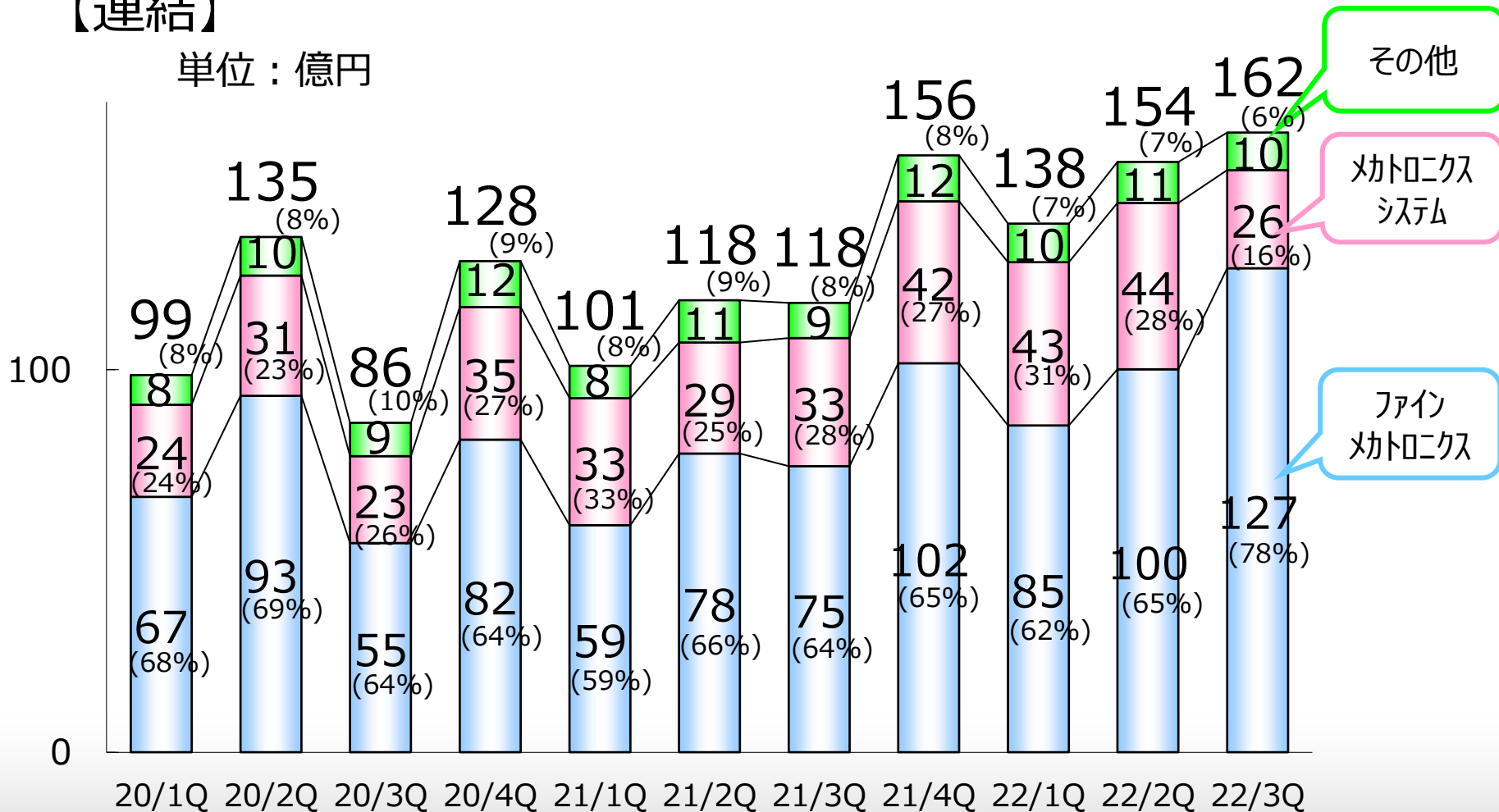
セグメント別売上高

【連結】

単位：億円

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置

エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



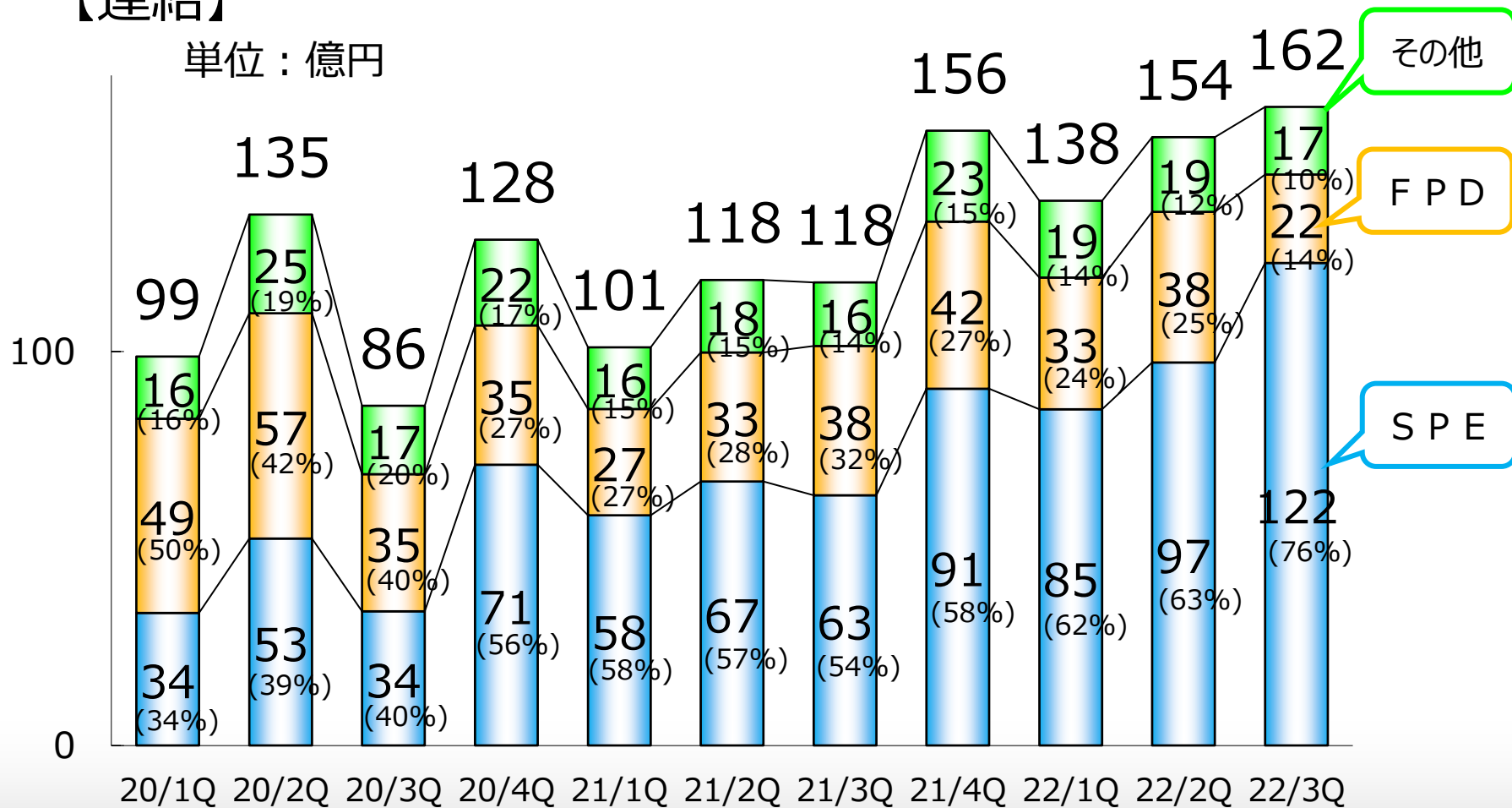
分野別売上高

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

【連結】

単位：億円



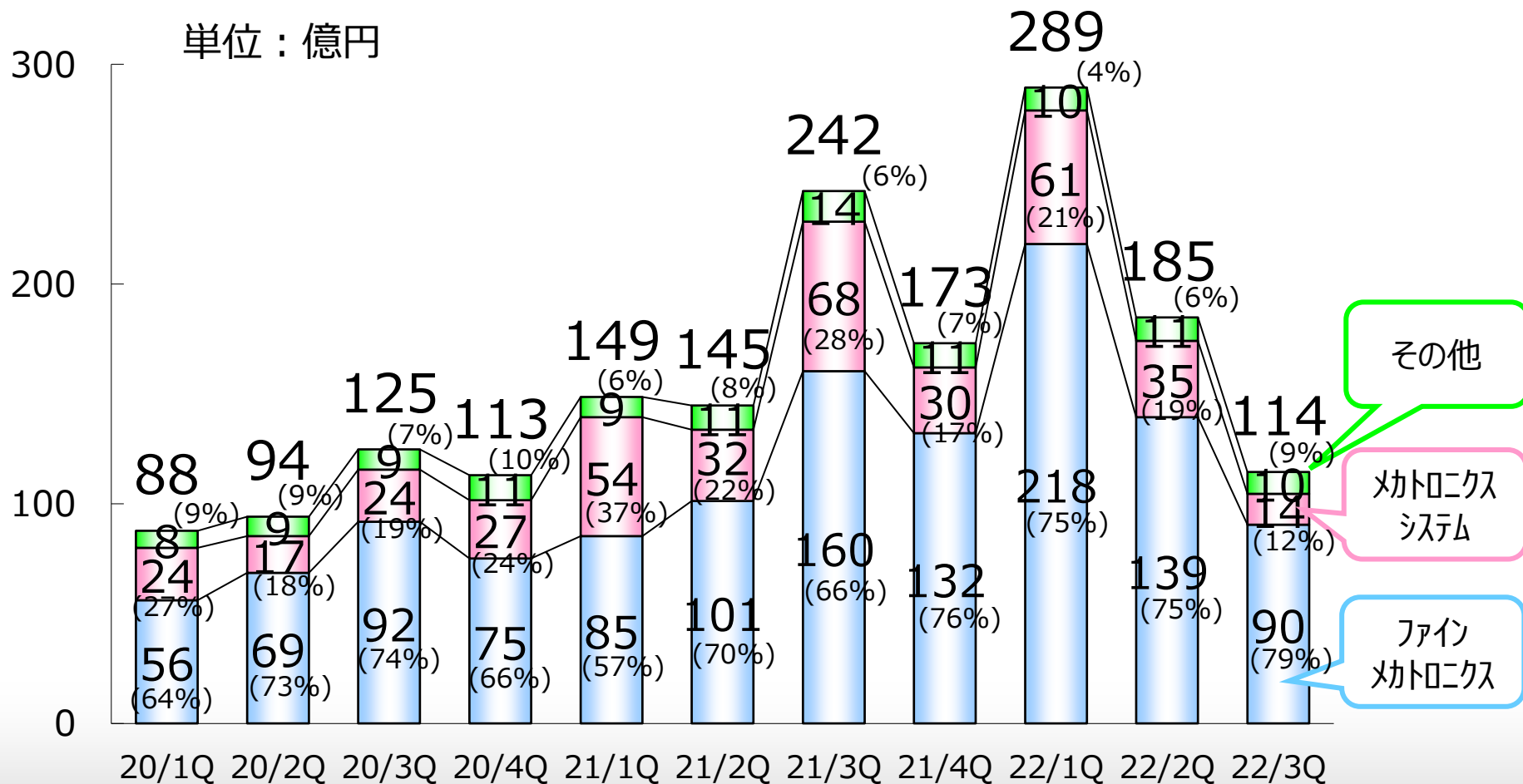
セグメント別受注高

* ファインエレクトロニクス：半導体/FPD前工程装置

エレクトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

【連結】

単位：億円



分野別受注高

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

【連結】

単位：億円

